Electronics for the Future

FY2026 1H 決算説明会

2026年11月6日
ローム株式会社
代表取締役社長　東 克己

業績報告

© ROHM Co., Ltd.

決算ハイライト

（単位：億円）

	FY2026 1H実績		YoY	FY2026 修正計画		YoY
売上高	2,795	-	+14.4%	5,500	-	+14.3%
営業利益	175	6.3%	+128.5%	500	9.1%	+360.2%
純利益	156	5.6%	+51.0%	450	8.2%	-
期中平均レート(¥/US$)	(160.02円)			(156.78円)		

上期実績	原材料価格やエネルギー・物流コストの上昇が続いているものの、売上増や償却費負担減少の効果により、営業利益は大きく改善。 AIサーバー向け中心の旺盛な需要に応えるため、生産能力の拡大を進める。
通期計画	自動車・産機・サーバー向けを中心に、想定を超える需要環境。構造改革は順調に進捗しており、値上げやコストダウンの効果も 徐々に業績に寄与してくる見通し。このような状況の中、業績予想を上方修正、前年比でも大きく改善。
今後の在庫・稼働方針	主要製品については極めて高い稼働水準が継続している。下期以降も強い需要に応えるため、生産能力拡大に努める。
配当	中間配当は1株当たり25円。期末配当も同額で年間配当は50円の予定で、配当性向は43%になる見込み。
事業・経営統合の進捗	協議は継続中。本件が当社及び関係当事者の企業価値向上に資するものとなるよう真摯かつ丁寧に協議を重ねている。

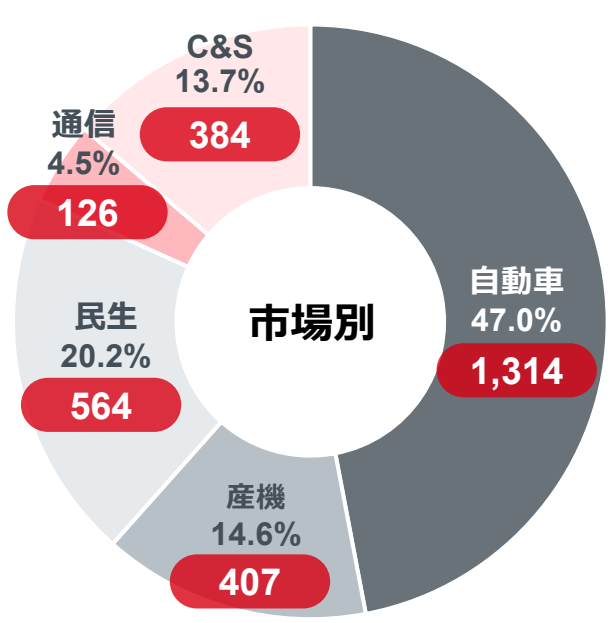
© ROHM Co., Ltd.

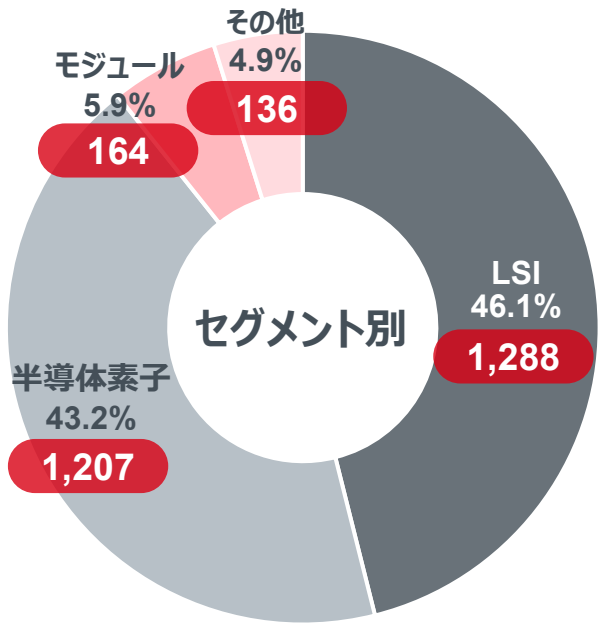
［FY2026 1H実績］売上構成比

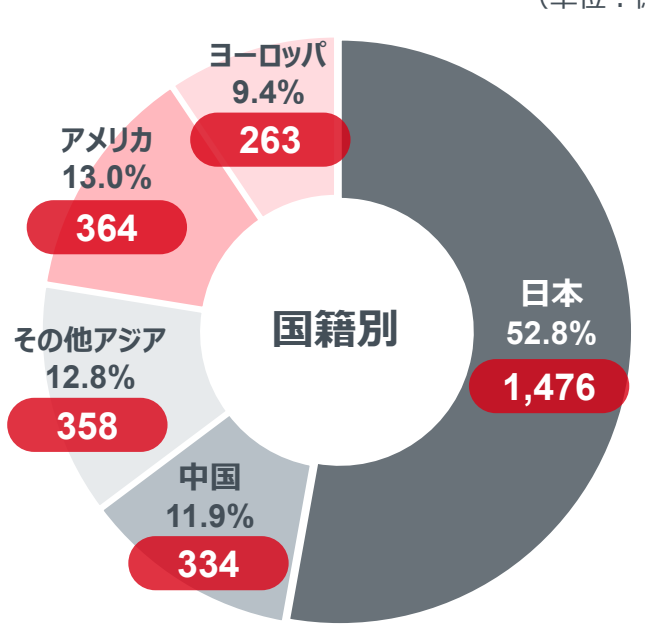
FY2025 1H実績 2,442億円

FY2026 1H実績 2,795億円 YoY +14.4%

（単位：億円）







市場	YoY
自動車	+15.2%
産機	+32.6%
民生	▲5.5%
通信	+27.9%
C&S	+28.5%

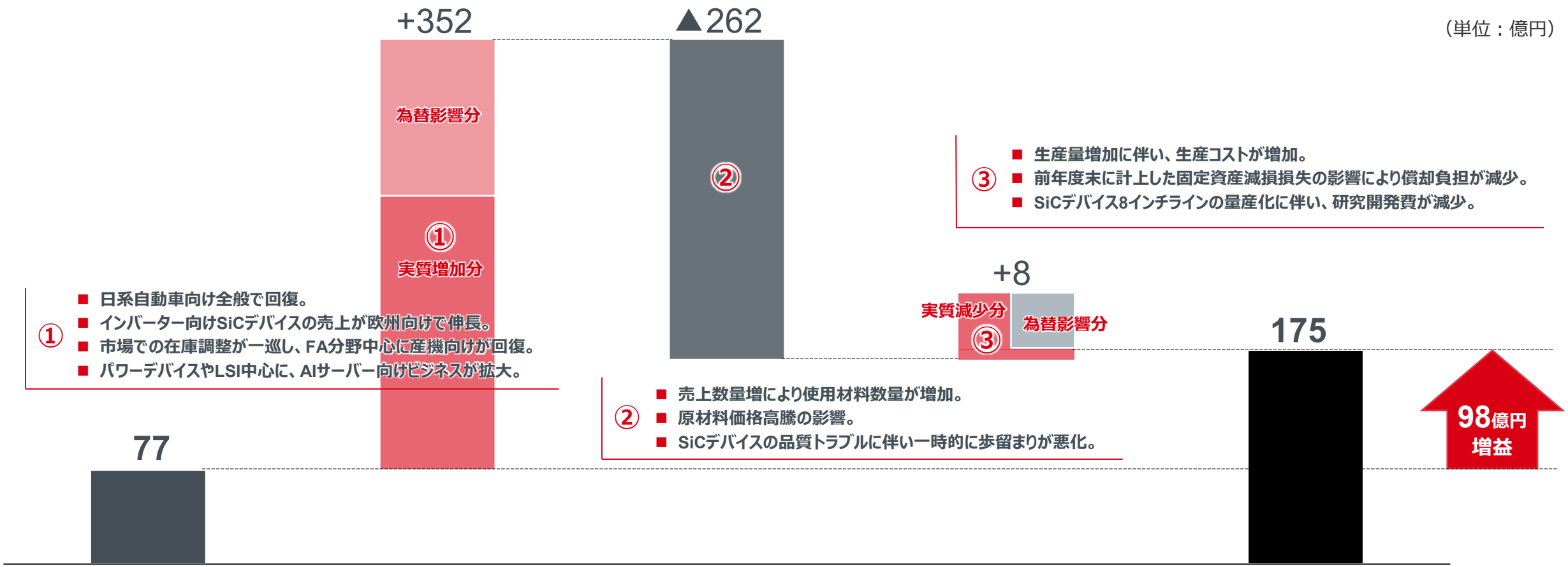
セグメント	YoY
LSI	+12.8%
半導体素子	+20.7%
モジュール	▲4.4%
その他	+5.2%

国籍	YoY
日本	+13.8%
中国	▲12.8%
その他アジア	+47.4%
アメリカ	+29.5%
ヨーロッパ	+10.4%

© ROHM Co., Ltd.

［FY2026 1H実績］営業利益 増減分析（YoY）

（単位：億円）



FY2025 1H 実績
（146.57円/US$）

売上増加	+352
為替影響	+128
実質増加	+224

市場別内訳

自動車	+173	通信	+28
産機	+100	C&S	+85
民生	▲33		

材料費及び在庫の影響	▲262
材料費	▲290
在庫の影響	+28

固定費の減少	+8
為替影響	▲46
実質減少	+54

製造原価

労務費	▲22
償却費	+73
経費	▲33

販管費

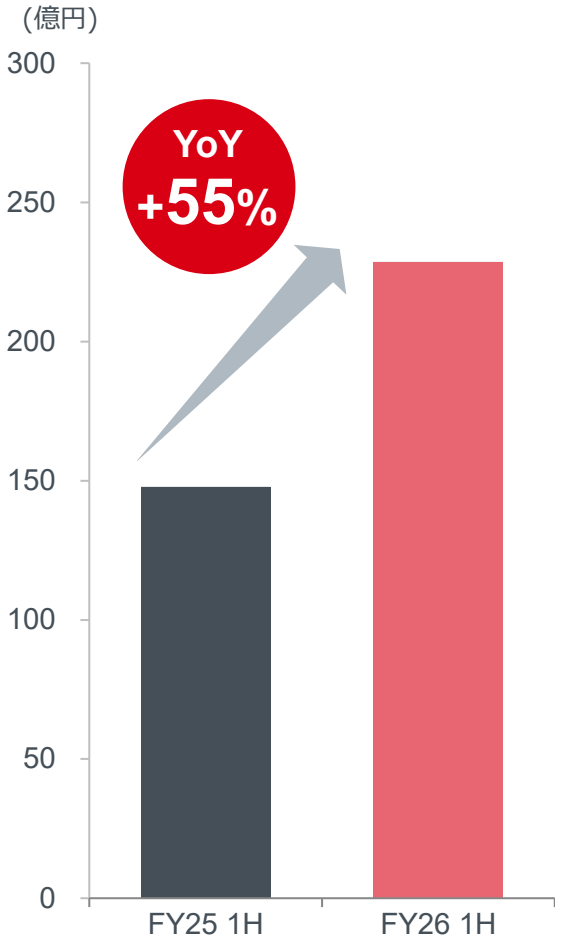
研究開発費	+21
その他	▲31

FY2026 1H 実績
（160.02円/US$）

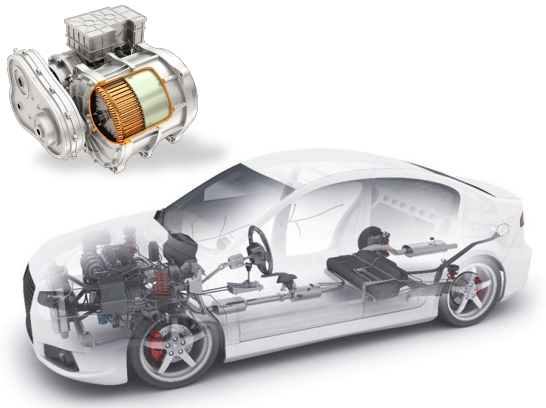
SiC事業 / サーバー向け　売上高

SiC事業

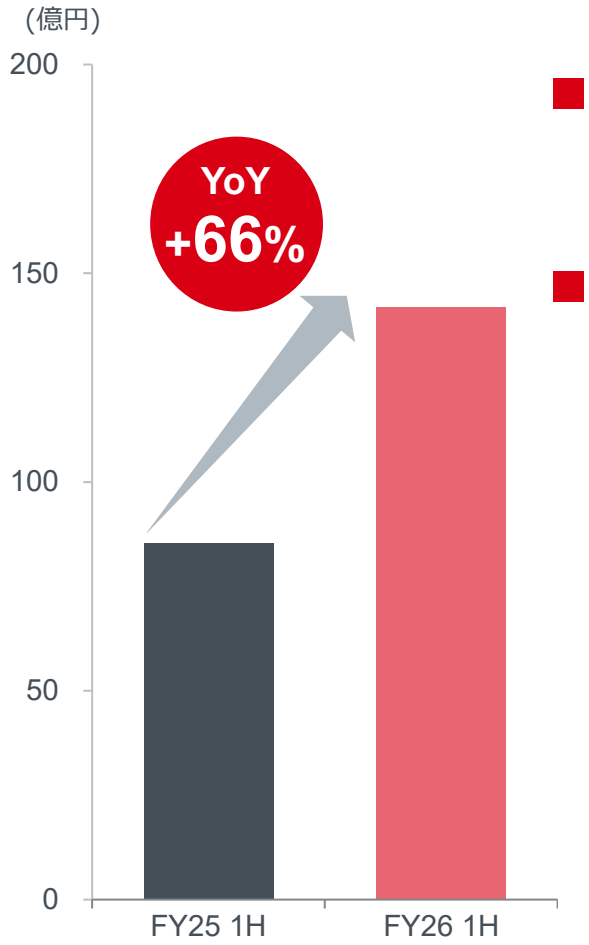
※ 基板事業は除く



- 欧州・日系を中心に
  自動車向けが堅調に推移
- AIサーバー向けの
  採用も着実に増加



サーバー向け



- Siパワーデバイスを
  中心に好調に推移
- さらに拡大する需要に
  対応するため、各種製品の
  生産能力UPにも取り組む



© ROHM Co., Ltd.

［FY2026 通期計画］ローム売上見通しサマリ

市場	2026年度の見通し	1H	2H
自動車 (+10.1%)	■ 全分野において、堅調に推移する見込み。 ■ 中でも、SiCデバイスが欧州・日系顧客向け中心に大きく伸長。xEV分野の成長を牽引。	+15.2%	+5.4%
産機 (+29.1%)	■ 長期化していた顧客の在庫調整が解消。 ■ AIサーバー関連の設備投資を背景に、FA中心に増加する見立て。	+32.6%	+25.6%
サーバー (+94.1%)	■ 市場の拡大や新製品の投入により採用が拡大。 引き合いは継続して強いものの、生産キャパシティを超える受注状況で受注残が増加。	+66.3%	+121.4%
民生その他 (+6.6%)	■ 前年度補助金の影響で好調だった中国の白物家電向けが反動減。 ■ アミューズメント向けの売上が大幅に増加、引き続き好調に推移する見通し。	+2.5%	+11.4%

括弧内はローム売上高YoY

【YoY】前年比
+10%～ / +10%～+2% / +2%～▲2% / ▲2%～▲10% / ▲10%～

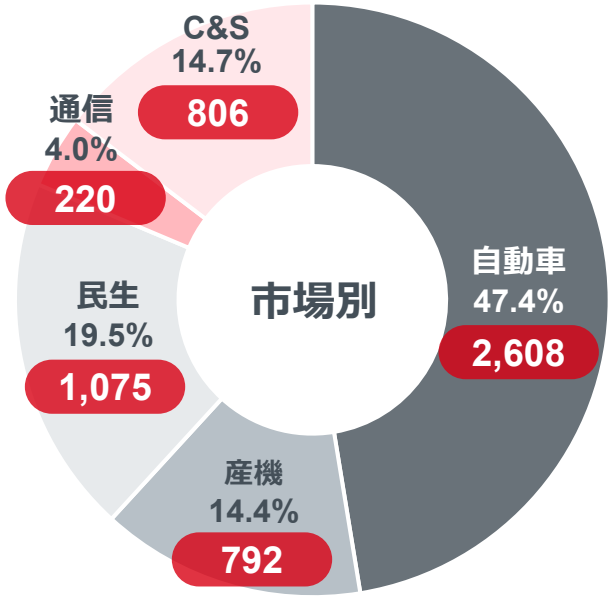
© ROHM Co., Ltd.

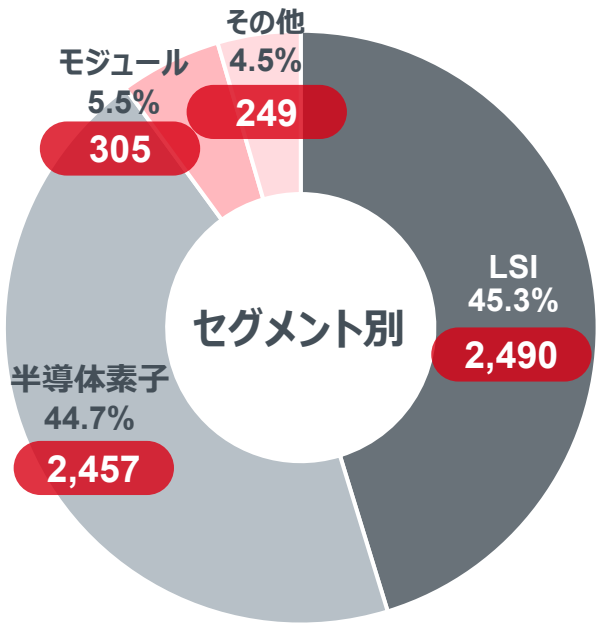
［FY2026 通期計画］売上構成比

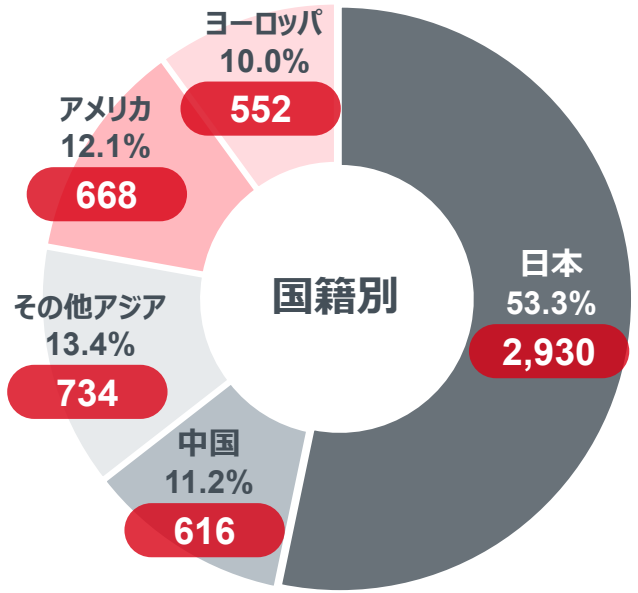
FY2025 通期実績 4,811億円

FY2026 通期計画 5,500億円 YoY +14.3%

（単位：億円）







市場	YoY
自動車	+10.1%
産機	+29.1%
民生	+1.9%
通信	+20.1%
C&S	+36.0%

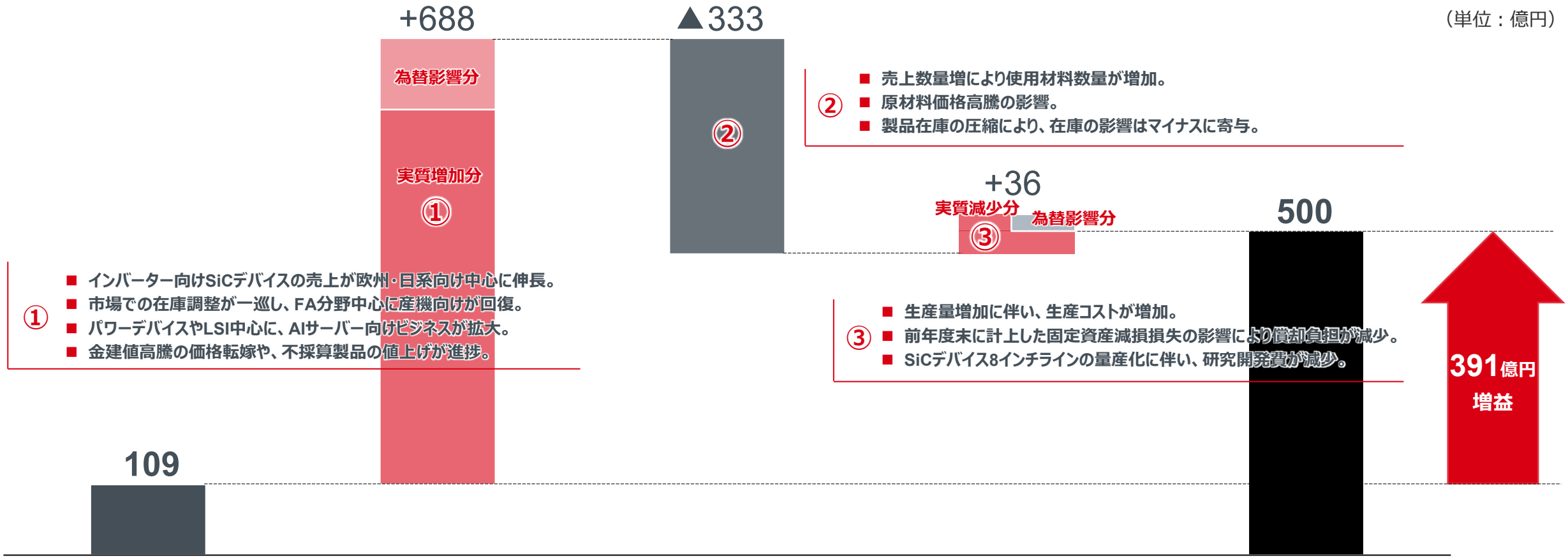
セグメント	YoY
LSI	+14.0%
半導体素子	+19.7%
モジュール	▲3.5%
その他	▲4.1%

国籍	YoY
日本	+16.1%
中国	▲12.5%
その他アジア	+46.6%
アメリカ	+19.4%
ヨーロッパ	+5.2%

© ROHM Co., Ltd.

［FY2026 通期計画］営業利益 増減分析（YoY）

（単位：億円）



①
- インバーター向けSiCデバイスの売上が欧州・日系向け中心に伸長。
- 市場での在庫調整が一巡し、FA分野中心に産機向けが回復。
- パワーデバイスやLSI中心に、AIサーバー向けビジネスが拡大。
- 金建値高騰の価格転嫁や、不採算製品の値上げが進捗。

②
- 売上数量増により使用材料数量が増加。
- 原材料価格高騰の影響。
- 製品在庫の圧縮により、在庫の影響はマイナスに寄与。

③
- 生産量増加に伴い、生産コストが増加。
- 前年度末に計上した固定資産減損損失の影響により償却負担が減少。
- SiCデバイス8インチラインの量産化に伴い、研究開発費が減少。

売上増加	+688
為替影響	+110
実質増加	+578

市場別内訳

自動車	+239	通信	+37
産機	+178	C&S	+213
民生	+21		

材料費及び在庫の影響	▲333
材料費	▲250
在庫の影響	▲83

固定費の減少	+36
為替影響	▲26
実質減少	+62

製造原価

労務費	▲20
償却費	+160
経費	▲93

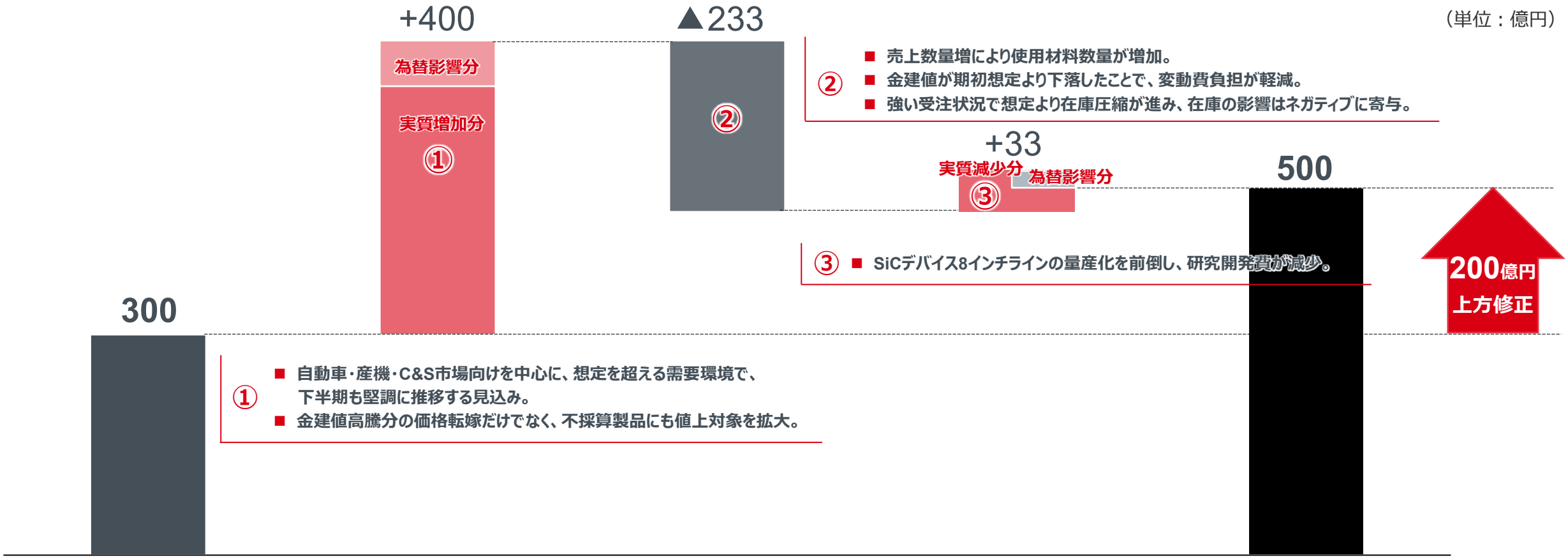
販管費

研究開発費	+53
その他	▲63

© ROHM Co., Ltd.

［FY2026 通期計画］営業利益 増減分析（期初計画比）

（単位：億円）



FY2026 期初計画
（153.53円/US$）

売上増加	+400
為替影響	+62
実質増加	+338

市場別内訳

自動車	+106	通信	+14
産機	+148	C&S	+95
民生	+36		

材料費及び在庫の影響	▲233
材料費	▲140
在庫の影響	▲93

固定費の減少	+33
為替影響	▲24
実質減少	+57

製造原価

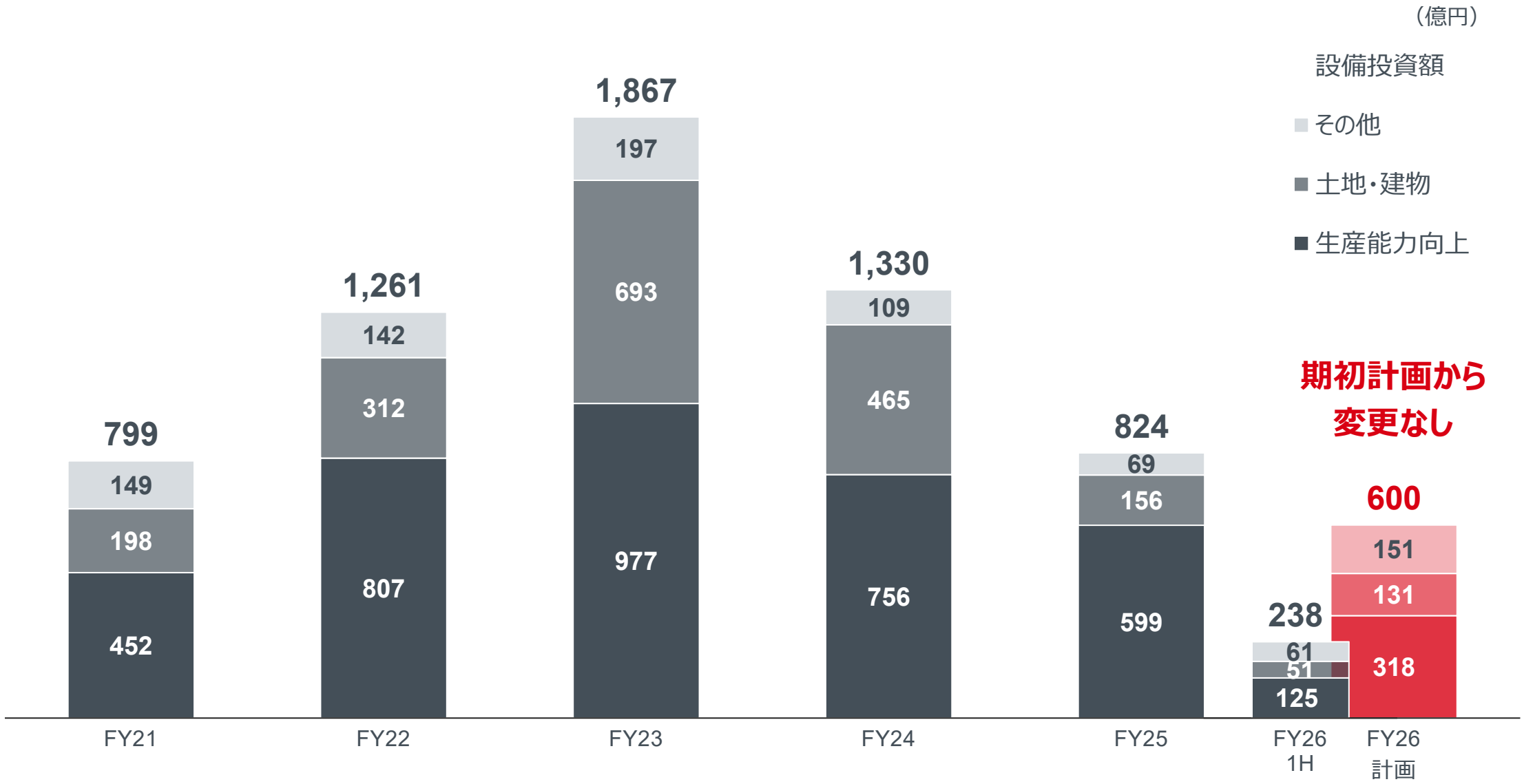
労務費	-
償却費	+6
経費	▲12

販管費

研究開発費	+65
その他	▲26

FY2026 修正計画
（156.78円/US$）

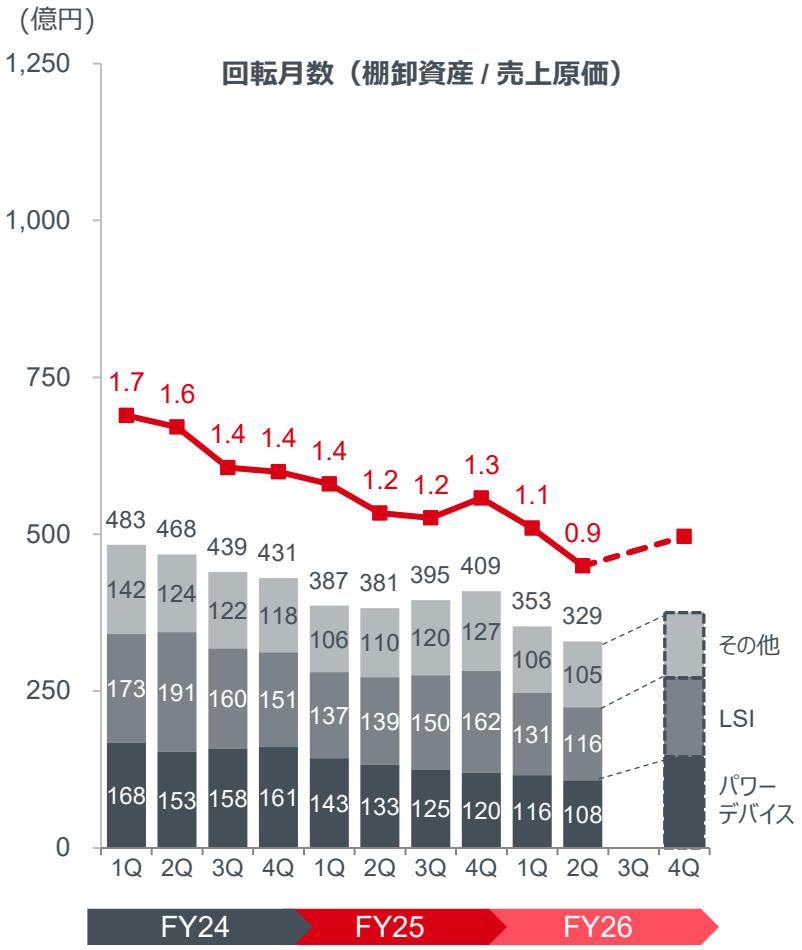
設備投資の状況


（億円）
設備投資額
その他
土地・建物
生産能力向上
799
149
198
452
1,261
142
312
807
1,867
197
693
977
1,330
109
465
756
824
69
156
599
238
61
51
125
600
151
131
318
期初計画から
変更なし
FY21
FY22
FY23
FY24
FY25
FY26
1H
FY26
計画

在庫の状況

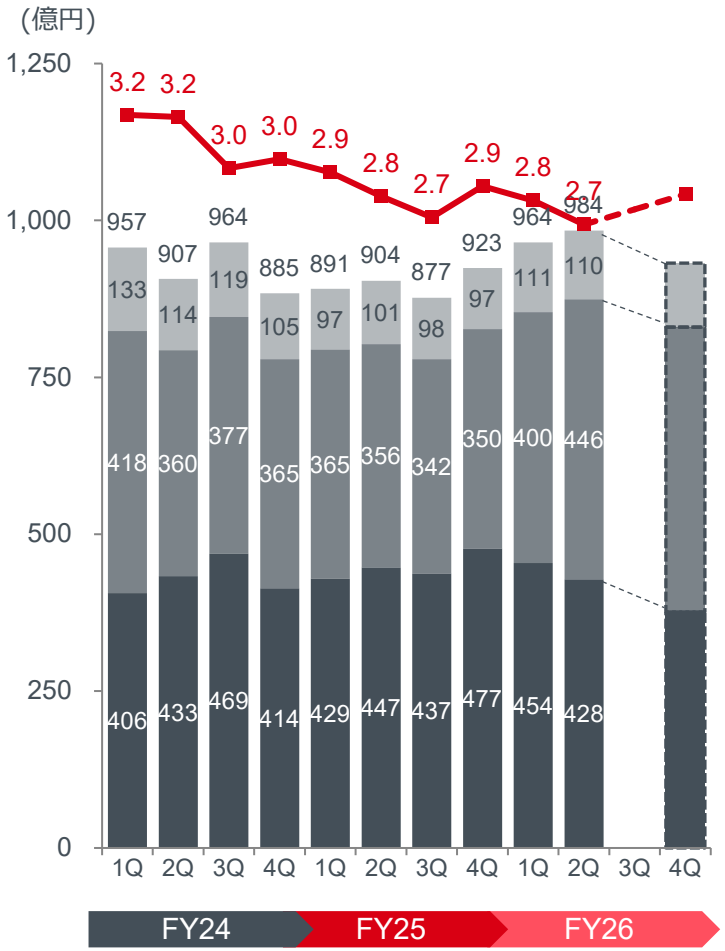
■ 商品及び製品

在庫調整は完了。今後は現状水準を維持しつつ、需要に合わせ増産していく。



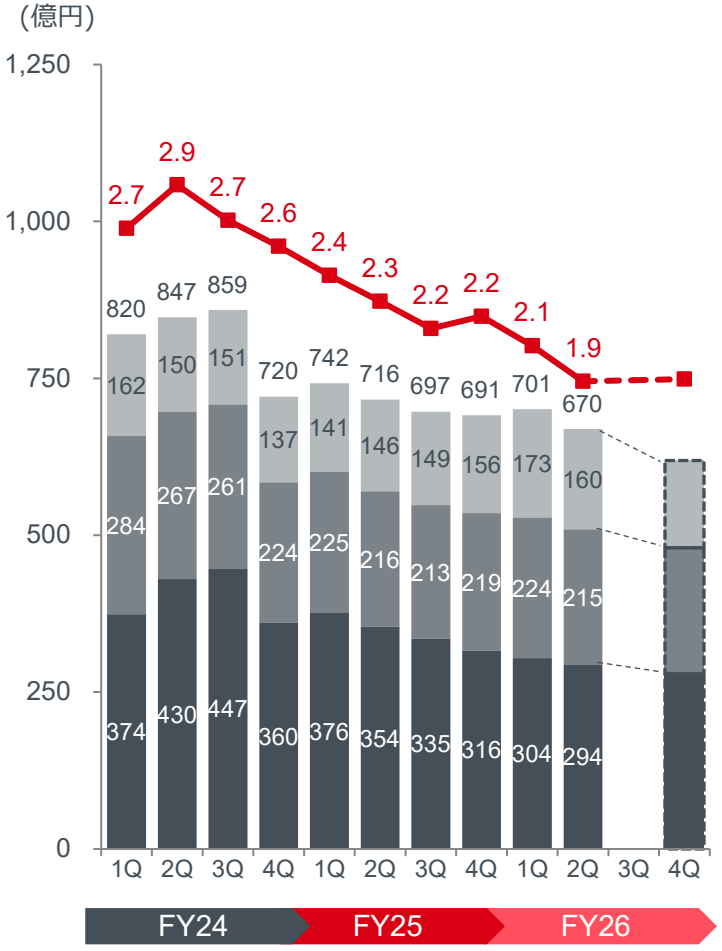
■ 仕掛品

生産リードタイムの短縮により、段階的に工程内在庫の圧縮を進める。



■ 原材料及び貯蔵品

LTAによる購入量を縮小し、新規購入量を抑制。現存在庫を確実に消費し圧縮を進める。

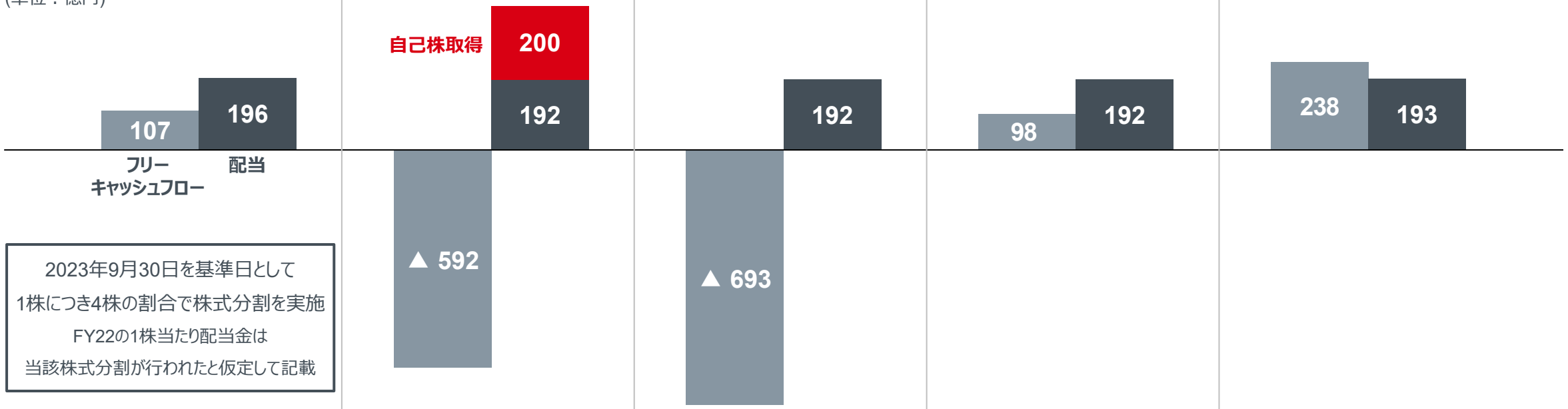


© ROHM Co., Ltd.

株主還元の推移

	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26（計画）
配当性向	24%	36%	-%	-%	43%
総還元性向	24%	73%	-%	-%	43%

(単位：億円)



2023年9月30日を基準日として
1株につき4株の割合で株式分割を実施
FY22の1株当たり配当金は
当該株式分割が行われたと仮定して記載

FY22	
年間配当	50円
中間	25円
期末	25円

FY23	
年間配当	50円
中間	25円
期末	25円

FY24	
年間配当	50円
中間	25円
期末	25円

FY25	
年間配当	50円
中間	25円
期末	25円

FY26（計画）	
年間配当	50円
中間	25円
期末	25円

＊フリーキャッシュフロー：純利益 ＋ 減価償却費 ＋ 減損損失 － 設備投資

© ROHM Co., Ltd.

構造改革

© ROHM Co., Ltd.

構造改革の進捗

構造改革は成果創出フェーズへ進み、利益改善が本格化

（単位：億円）

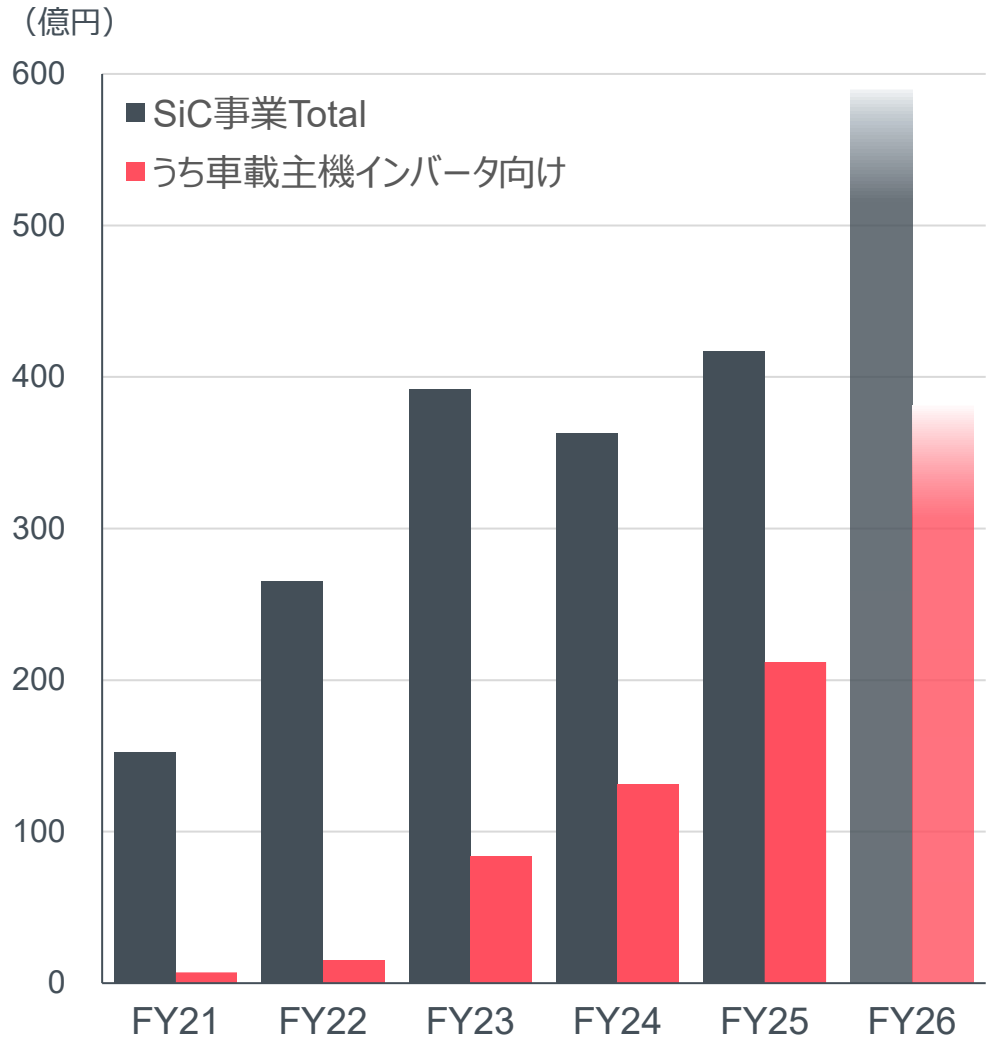
改革の内容（一部抜粋）		FY2025比 利益改善額 FY2026	FY2027	FY2028
SiC事業の収益性改善	■ デバイス第5世代投入、歩留まり改善 ■ 6インチから8インチ生産への早期移行 ■ 売上成長(xEV向けシェアアップ、AIサーバー向け急拡大)			
製造コストダウン 調達コスト適正化	■ 生産性改善 ■ 金→銅ワイヤへの切替え ■ 物流、倉庫コスト削減 ■ 生産拠点再編（国内2拠点ラストバイ生産、海外1拠点譲渡売却） ■ 電力調達コスト適正化 ■ 材料調達コスト減			
価格適正化 (SiC事業除く) 事業ポートフォリオ適正化 業務効率改善	■ Au高騰による価格転嫁 ■ 不採算製品撤退・値上げ ■ 新プライシング制度の導入開始 ■ 間接費用の低減			
売上成長 (SiC事業除く)	■ xEVを中心とした既存市場 ■ AIサーバー向け新規参入			
営業利益改善額		**> 400**	**> 700**	**>> 1,000**

SiCパワーデバイス事業

© ROHM Co., Ltd.

SiC事業の売上推移

■ SiC事業の売上推移



■ SiC事業の売上伸長率

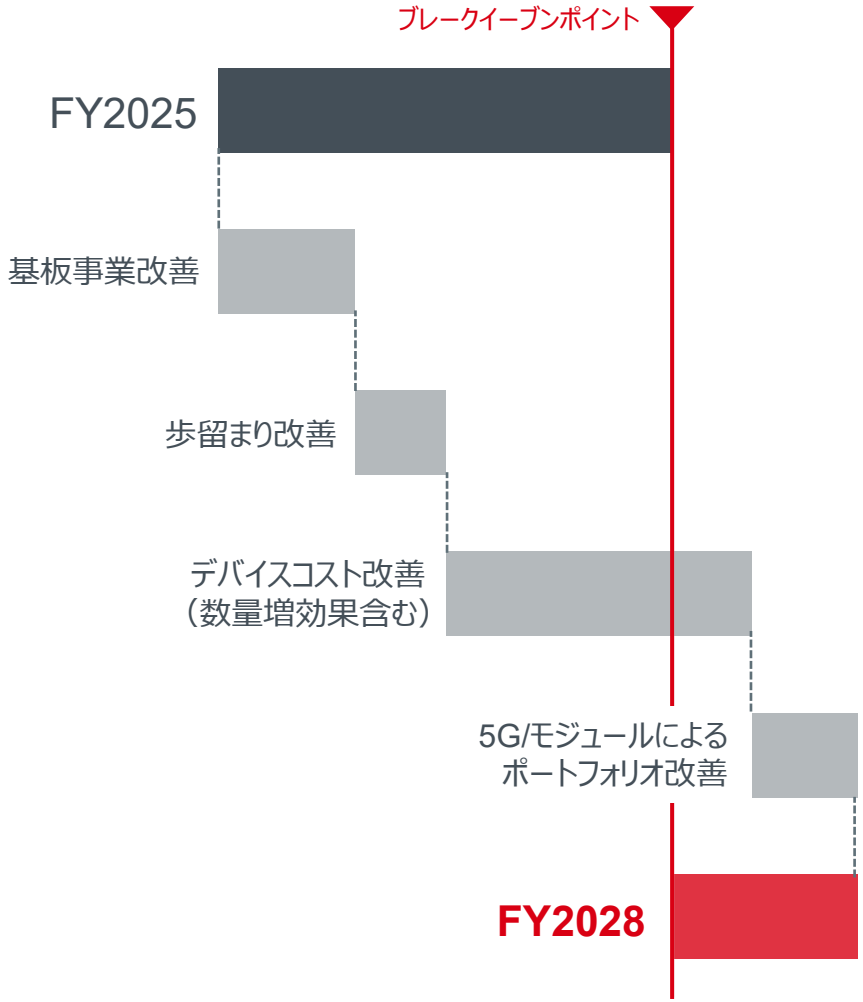
YoY	FY25	FY26
SiC事業	+14%	> +30%
SiCデバイス・モジュール事業 （SiC基板事業除く）	+41%	> +55%

- 車載インバータ向けが売上増を牽引
  - 計画通りHEV向けで採用拡大
  - SiCモジュール、US大手OEMにて2028年モデル採用決定
- コンピュータ・ストレージ（AIサーバー電源向け）分野の売上は期初計画に対して上振れで進捗
- 第5世代SiC MOSFET 8インチ品を筑後工場で量産開始し、10月より売上寄与、年度末に向け大きく増産
- 宮崎第2工場の8インチデバイス生産も1年前倒し、FY2027 2Qより量産開始予定

© ROHM Co., Ltd.

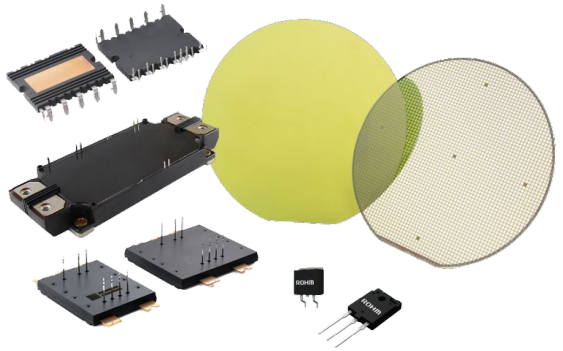
SiC事業の黒字化に向けた取り組み

黒字化への道筋



黒字化に向けた主な取り組み

- 黒字化達成時期1年前倒しを目指す（FY2028→FY2027）
- FY2026から段階的にAIサーバー向け需要増加と値上げ効果が利益率向上に寄与
- FY2027から宮崎第2工場FABラインの稼働を開始し、8インチキャパ増強
- FY2028までに筑後工場6インチラインを8インチラインへ転換し、生産効率と収益性向上、合わせてキャパ増強
- ディスクリート、モジュールの売上比率が順次拡大し、ポートフォリオ改善が進む





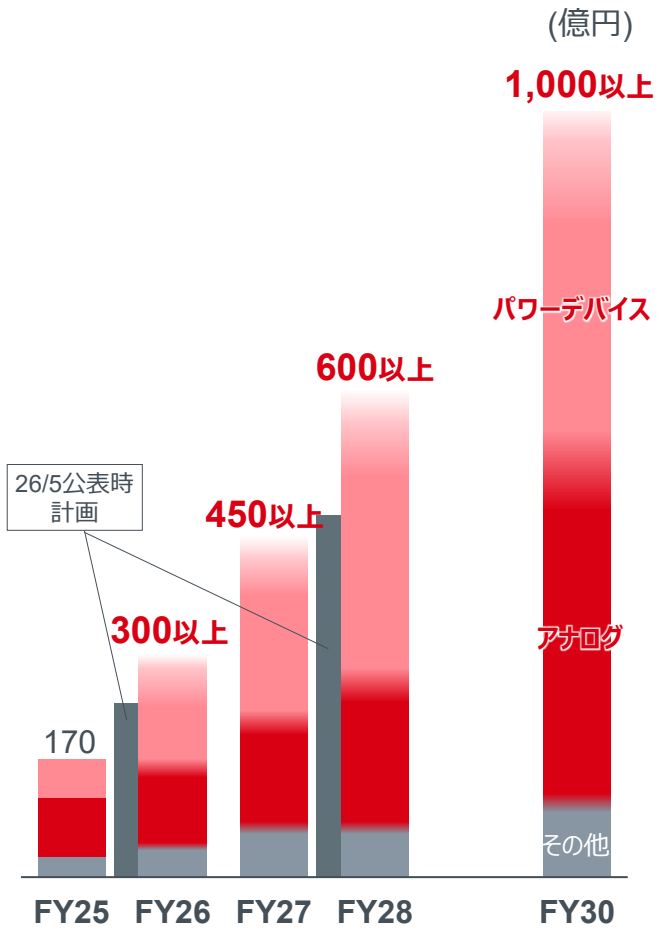
サーバー向けビジネス

© ROHM Co., Ltd.

サーバー向けビジネスの売上目標

AIサーバー向けを中心とした、ローム各製品の採用拡大および新製品開発を本格化

サーバー向け売上目標と進捗



製品ラインアップ



Power Supply

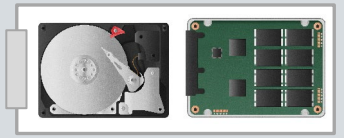
AC-DC: AC / 800V + DC-DC: 800V / 800V → 800V$_{DC}$

EcoSiC

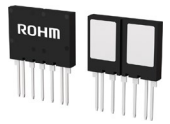
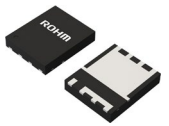
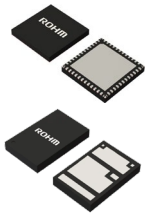
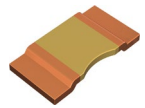
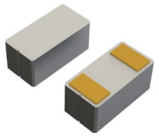
Main board

DC-DC: 800V / IBV + DC-DC: IBV / xV





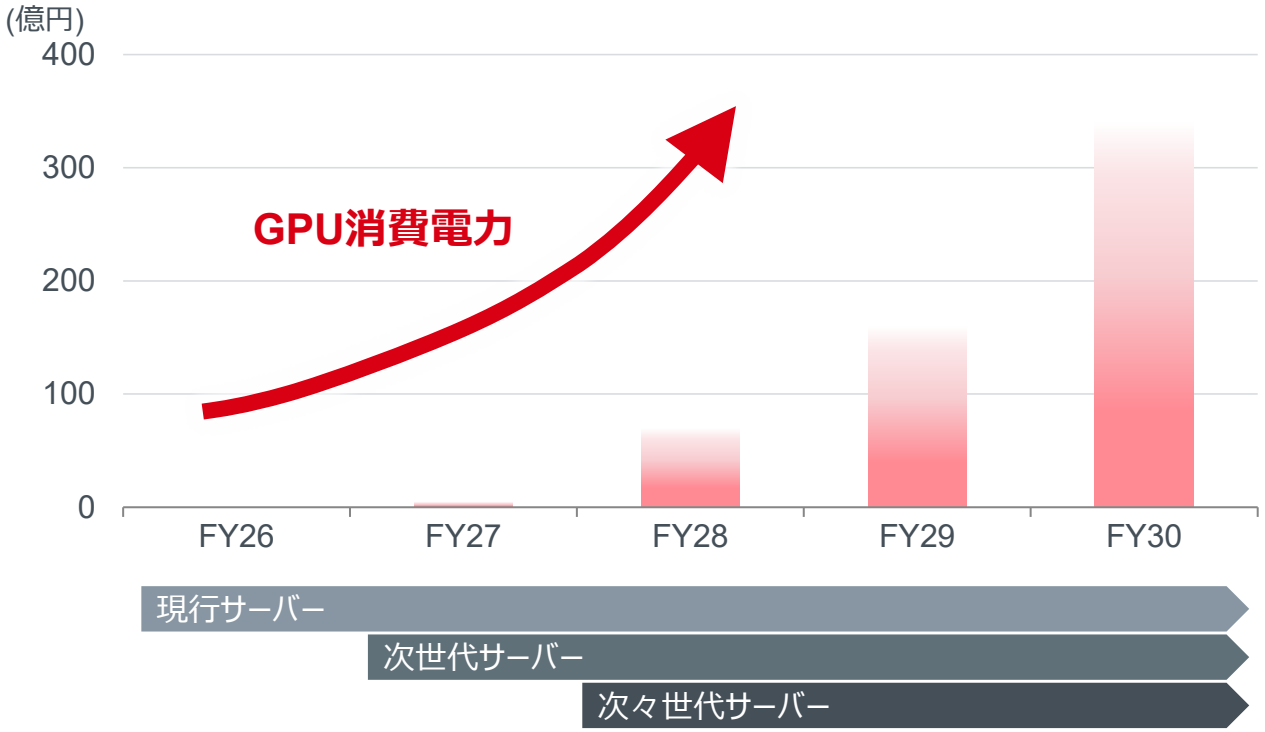
EcoGaN EcoMOS

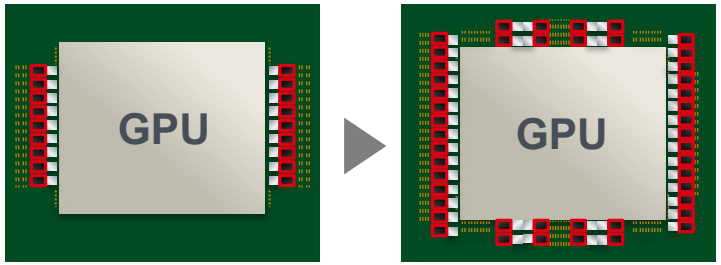
Power				Analog			Others	
SiC MOSFET	GaN HEMT	Si MOSFET		MPC + DrMOS	HSC	SSD PMIC	Shunt Resistors	Si Capacitor
								
DOT-247	GNP2070TD-Z	RY7P250BM	RS7N200BH		BD12780MUV	BD72649GWV		
Low Ron	Low FOM*1	Wide SOA/Low Ron		High speed control	High speed response	High efficiency	Small and High accurate TCR	Low loss

*1:FOM(Figure of merit) = Ron*Qoss

高効率DrMOS：技術確立を経て、本格的な拡販フェーズへ

DrMOS売上高の見通し



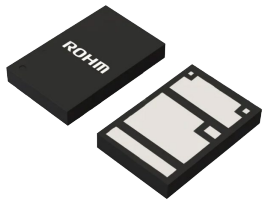


GPU消費電力の上昇に伴い、DrMOS使用数量がアップ

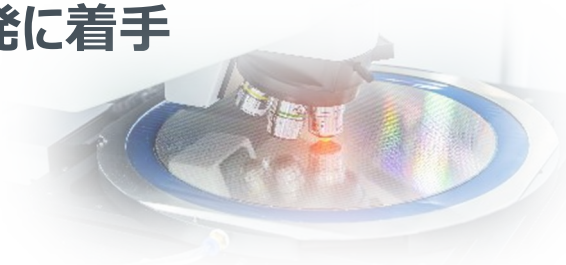
□：DrMOS搭載箇所

第2世代の拡販と次世代プロセスの開発を両輪で推進

■ 第2世代の開発完了

第1世代	第2世代
	 開発完了
市場開拓	**グローバル大手顧客で採用検討案件が着実に拡大**
• 市場投入にて、顧客評価を得る	• 高効率・高信頼性を実現 • 技術確立から拡販フェーズへ

■ 次世代プロセスの開発に着手



© ROHM Co., Ltd.



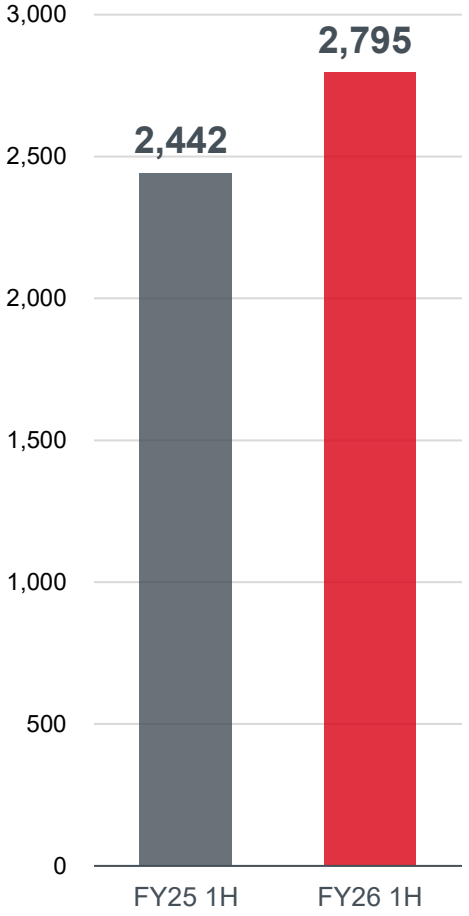
Electronics for the Future

［FY2026 1H実績］市場別売上の変動要因（YoY）

（単位：億円）

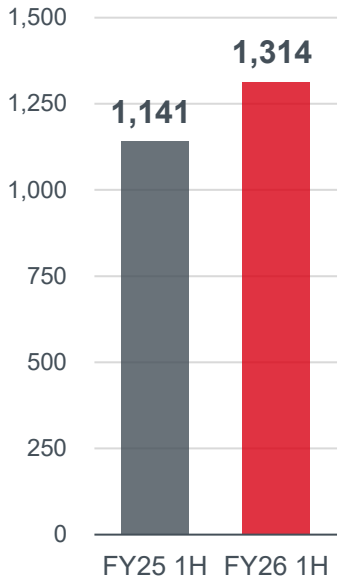
1H売上高

+14.4%



自動車

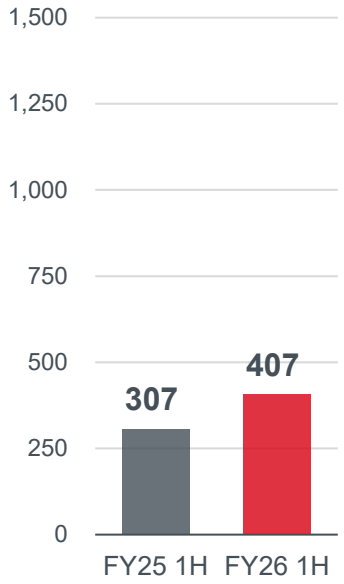
+15.2%



インフォテインメント	+27
ボディ	+27
パワートレイン	+18
安全走行ADAS	+0
xEV	+69
その他	+31

産機

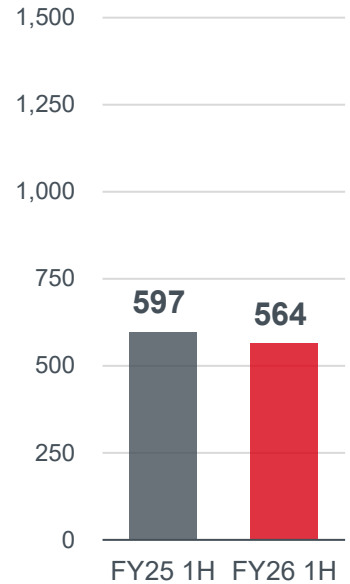
+32.6%



FA	+27
エネルギー	+0
ホームビルディング	+24
その他	+49

民生

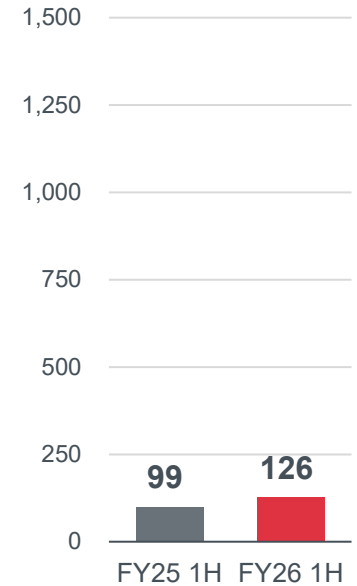
▲5.5%



AV関連	+3
家電	▲29
その他	▲7

通信

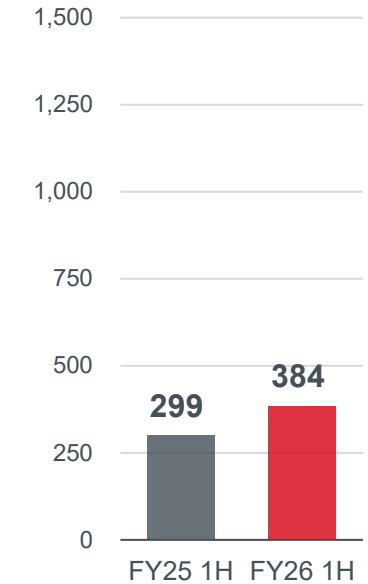
+27.9%



スマホ&モバイル	+21
基地局&インフラ	+4
有線通信	+2

コンピュータ & ストレージ

+28.5%



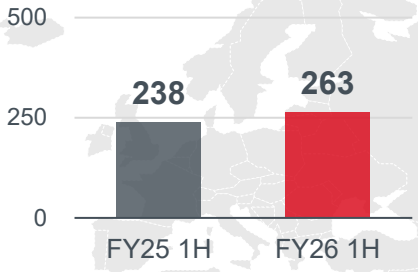
PC&サーバー	+90
決済端末	▲12
事務機	+7

［FY2026 1H実績］国籍別売上の変動要因（YoY）

1H 売上高	2,442億円 FY2025 1H実績	2,795億円 FY2026 1H実績	+14.4%

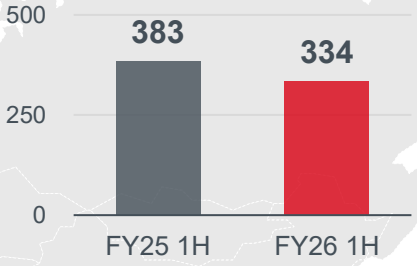
海外売上高比率	46.9% FY2025 1H実績	47.2% FY2026 1H実績

欧州 +10.4%



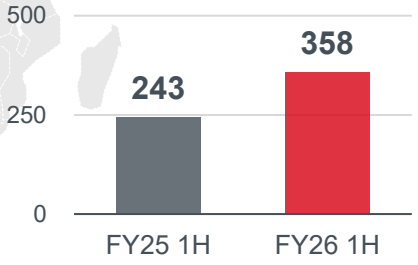
自動車	+23	通信	+0
産機	+3	C&S	▲4
民生	+3		

中国 ▲12.8%



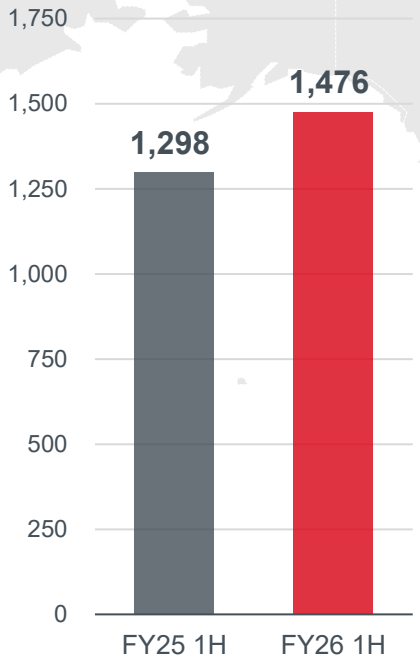
自動車	▲9	通信	+3
産機	▲7	C&S	+0
民生	▲37		

その他アジア +47.4%



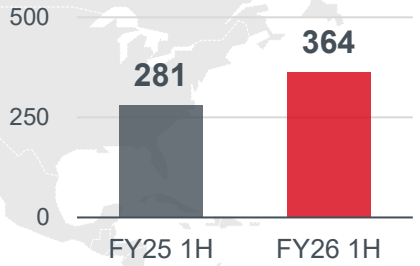
自動車	+29
産機	+9
民生	+12
通信	+1
C&S	+64

日本 +13.8%



自動車	+107	通信	+1
産機	+74	C&S	+14
民生	▲17		

米州 +29.5%



自動車	+24	通信	+21
産機	+21	C&S	+11
民生	+6		

※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位：億円)

© ROHM Co., Ltd.

［FY2026 1H実績］セグメント利益（YoY）

（単位：億円）

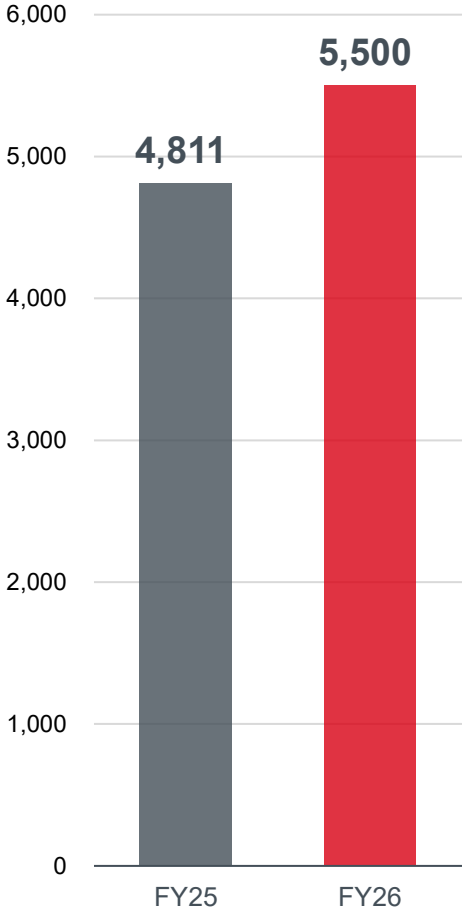
		FY2026 1H 実績	FY2025 1H 実績	増減額	増減率
LSI	売上	1,288	1,142	+146	+12.8%
	セグメント利益	176	130	+46	+35.5%
	（利益率）	(13.6%)	(11.3%)	-	-
半導体素子	売上	1,207	1,000	+207	+20.7%
	セグメント利益	▲44	▲98	+54	-
	（利益率）	(▲3.6%)	(▲9.8%)	-	-
モジュール	売上	164	171	▲7	▲4.4%
	セグメント利益	17	24	▲7	▲30.0%
	（利益率）	(10.4%)	(14.2%)	-	-
その他	売上	136	129	+7	+5.2%
	セグメント利益	18	21	▲3	▲10.3%
	（利益率）	(13.6%)	(16.0%)	-	-

［FY2026 通期計画］市場別売上の変動要因（YoY）

（単位：億円）

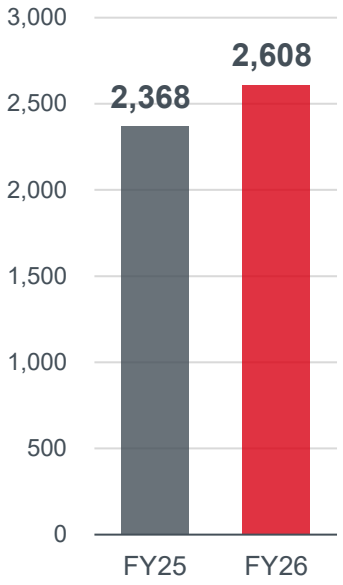
通期売上高

+14.3%



自動車

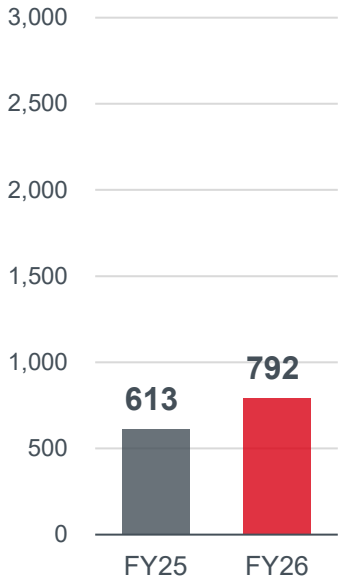
+10.1%



インフォテインメント	+30
ボディ	+18
パワートレイン	+26
安全走行ADAS	▲1
xEV	+137
その他	+30

産機

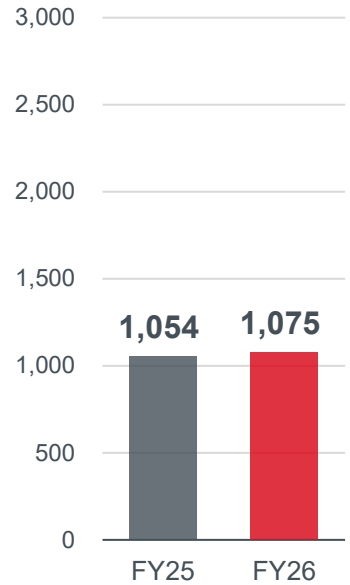
+29.1%



FA	+67
エネルギー	+9
ホームビルディング	+35
その他	+68

民生

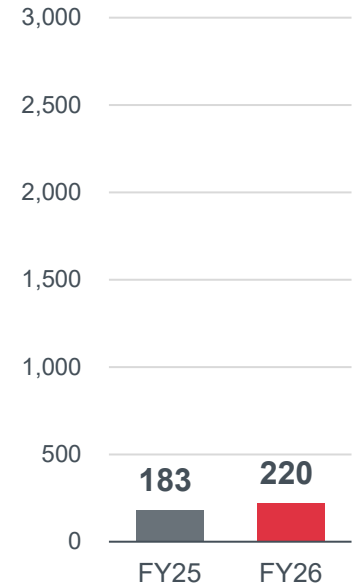
+1.9%



AV関連	+7
家電	▲25
その他	+39

通信

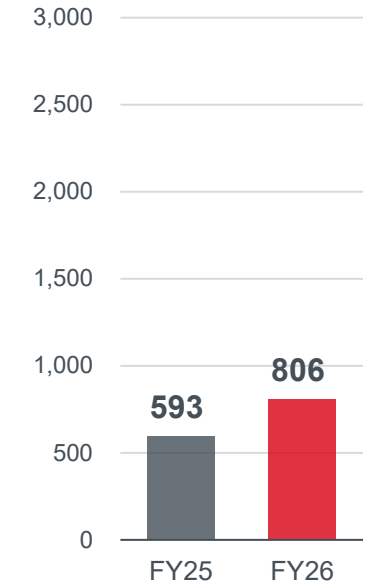
+20.1%



スマホ&モバイル	+28
基地局&インフラ	+8
有線通信	+1

コンピュータ & ストレージ

+36.0%



PC&サーバー	+214
決済端末	▲23
事務機	+22

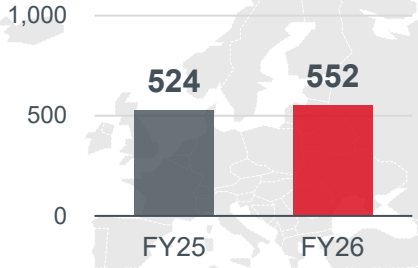
© ROHM Co., Ltd.

［FY2026 通期計画］国籍別売上の変動要因（YoY）

通期売上高	FY2025 実績	FY2026 計画	
	4,811億円	5,500億円	+14.3%

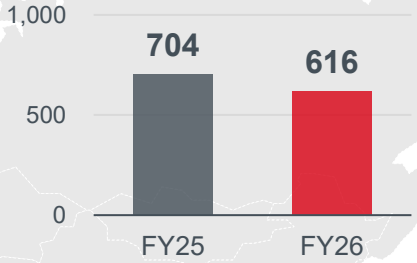
海外売上高比率	FY2025 実績	FY2026 計画
	47.6%	46.7%

欧州 +5.2%



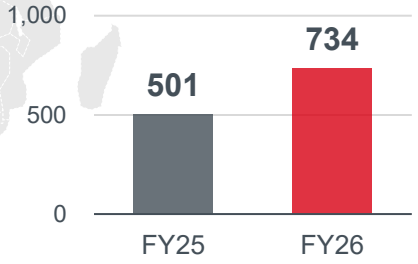
自動車	+14	通信	▲0
産機	+9	C&S	+1
民生	+4		

中国 ▲12.5%



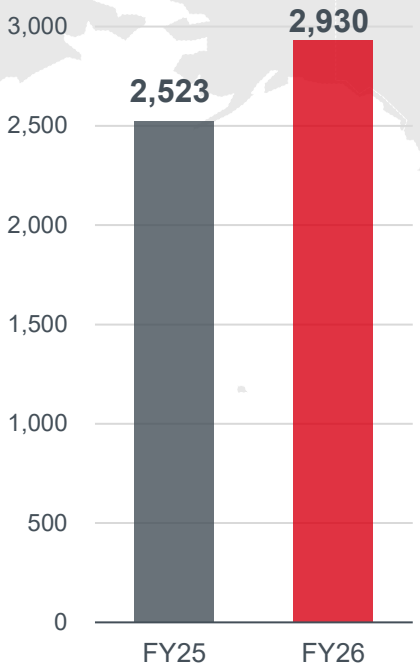
自動車	▲40	通信	+1
産機	▲9	C&S	+1
民生	▲41		

その他アジア +46.6%



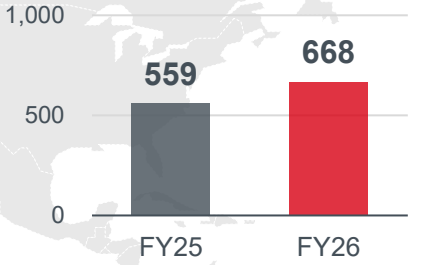
自動車	+45
産機	+18
民生	+22
通信	▲0
C&S	+149

日本 +16.1%



自動車	+199	通信	+1
産機	+133	C&S	+27
民生	+47		

米州 +19.4%



自動車	+22	通信	+35
産機	+27	C&S	+35
民生	▲12		

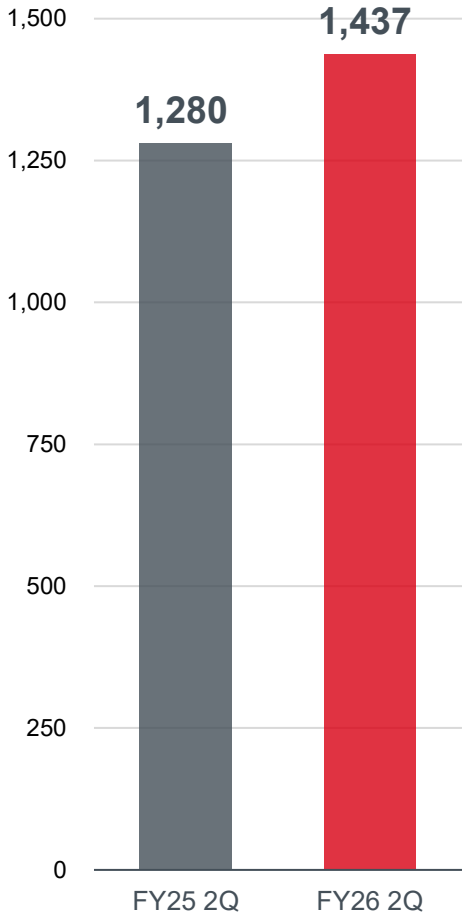
※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位：億円)

［FY2026 2Q実績］市場別売上の変動要因（YoY）

（単位：億円）

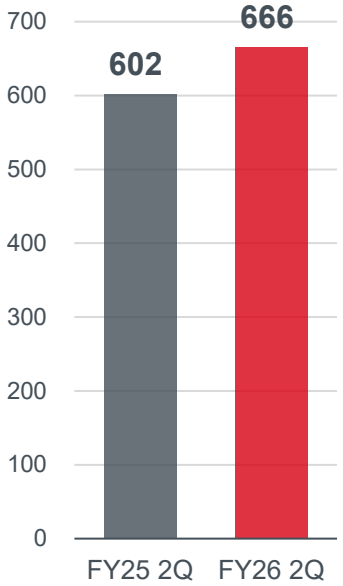
四半期売上高

+12.3%



自動車

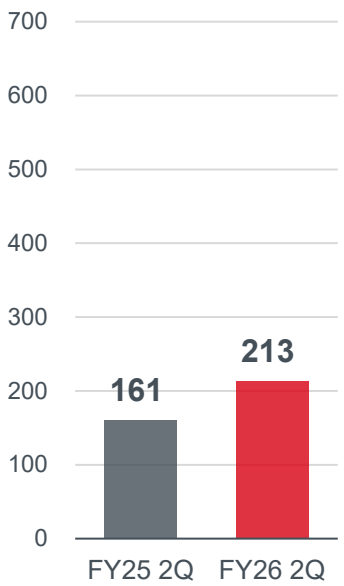
+10.6%



インフォテインメント	+13
ボディ	+8
パワートレイン	+8
安全走行ADAS	+0
xEV	+26
その他	+9

産機

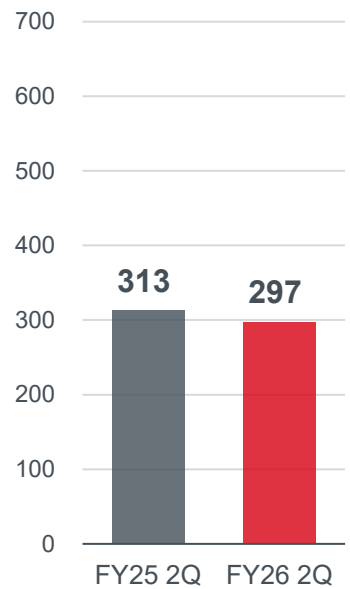
+32.6%



FA	+14
エネルギー	+1
ホームビルディング	+13
その他	+24

民生

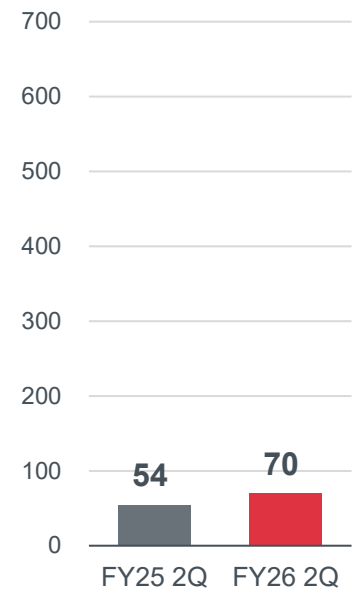
▲4.9%



AV関連	+2
家電	▲10
その他	▲7

通信

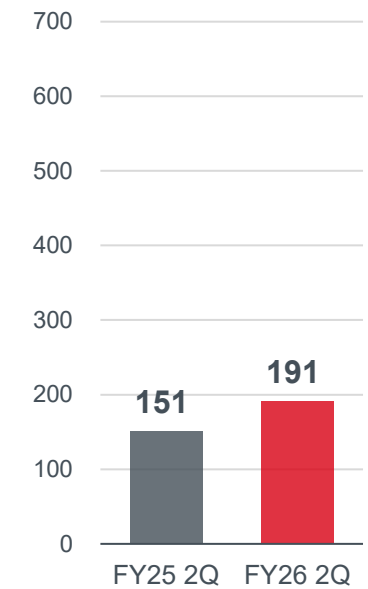
+29.2%



スマホ&モバイル	+11
基地局&インフラ	+4
有線通信	+1

コンピュータ & ストレージ

+26.7%



PC&サーバー	+48
決済端末	▲10
事務機	+2

© ROHM Co., Ltd.

［FY2026 2Q実績］国籍別売上の変動要因（YoY）

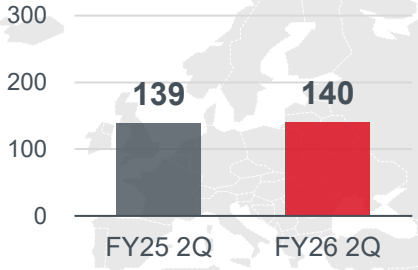
四半期売上高

1,280億円 FY2025 2Q実績 ▶ **1,437億円** FY2026 2Q実績　+12.3%

海外売上高比率

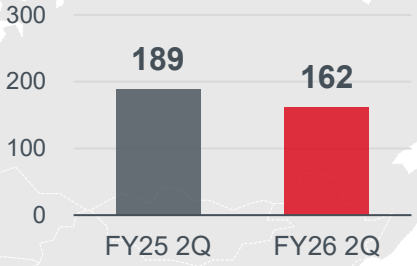
46.7% FY2025 2Q実績 ▶ **46.9%** FY2026 2Q実績

欧州　+0.9%



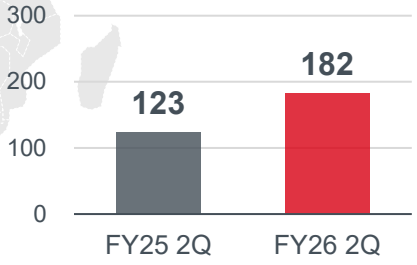
自動車	+0	通信	+0
産機	+1	C&S	▲2
民生	+2		

中国　▲14.3%



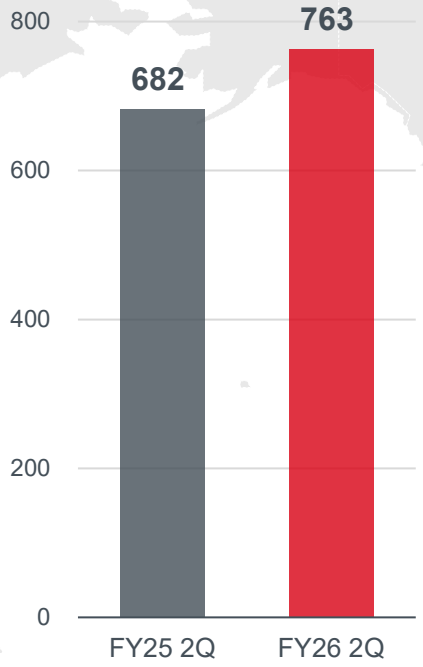
自動車	▲9	通信	+2
産機	▲2	C&S	▲2
民生	▲16		

その他アジア　+47.3%



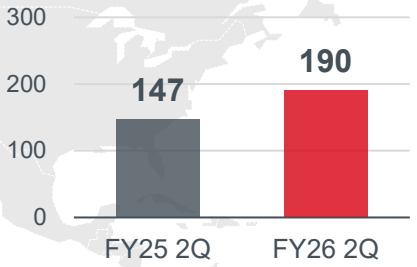
自動車	+13
産機	+4
民生	+8
通信	+0
C&S	+33

日本　+11.9%



自動車	+49	通信	+1
産機	+39	C&S	+6
民生	▲14		

米州　+29.7%



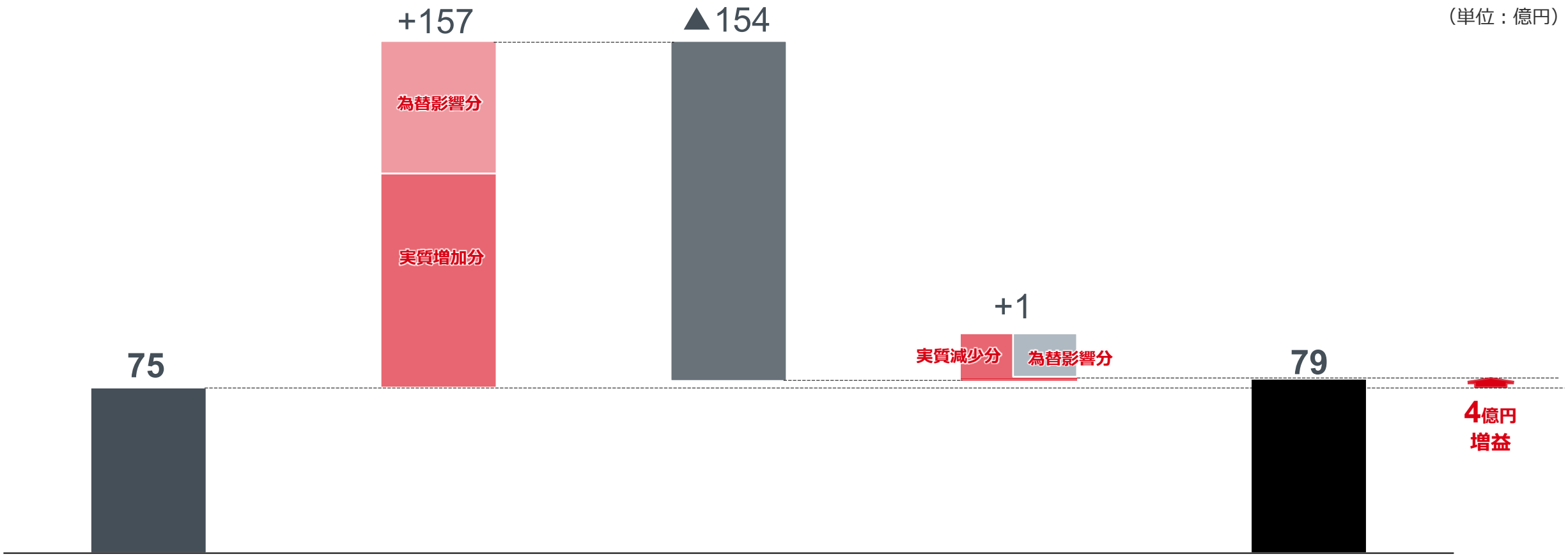
自動車	+11	通信	+13
産機	+10	C&S	+5
民生	+5		

※取引先企業の国籍別 売上を集計（単位：億円）

© ROHM Co., Ltd.

［FY2026 2Q実績］営業利益 増減分析（YoY）

（単位：億円）



売上増加	+157
為替影響	+60
実質増加	+97

材料費及び在庫の影響	▲154
材料費	▲147
在庫の影響	▲7

固定費の減少	+1
為替影響	▲20
実質減少	+21

市場別内訳

自動車	+64	通信	+16
産機	+52	C&S	+40
民生	▲15		

製造原価

労務費	▲4
償却費	+34
経費	▲13

販管費

研究開発費	+9
その他	▲25

© ROHM Co., Ltd.

［FY2026 2Q実績］セグメント利益（YoY）

（単位：億円）

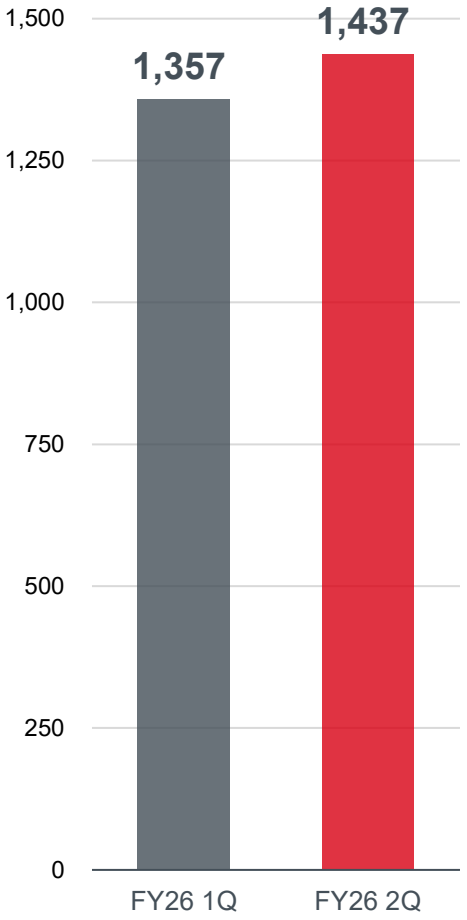
		FY2026 2Q 実績	FY2025 2Q 実績	増減額	増減率
LSI	売上	667	594	+73	+12.2%
	セグメント利益	102	86	+16	+18.7%
	（利益率）	(15.4%)	(14.5%)	-	-
半導体素子	売上	618	529	+89	+16.8%
	セグメント利益	▲34	▲35	+1	-
	（利益率）	(▲5.6%)	(▲6.7%)	-	-
モジュール	売上	83	91	▲8	▲9.0%
	セグメント利益	7	16	▲9	▲56.3%
	（利益率）	(8.2%)	(17.2%)	-	-
その他	売上	70	66	+4	+6.0%
	セグメント利益	9	10	▲1	▲9.3%
	（利益率）	(13.5%)	(15.8%)	-	-

［FY2026 2Q実績］市場別売上の変動要因（QoQ）

（単位：億円）

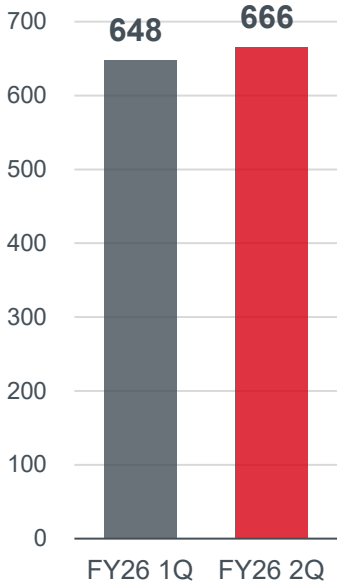
四半期売上高

+5.9%



自動車

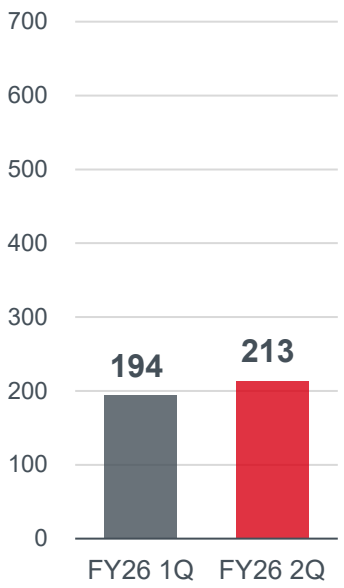
+2.8%



インフォテインメント	+1
ボディ	▲0
パワートレイン	+1
安全走行ADAS	+0
xEV	+21
その他	▲5

産機

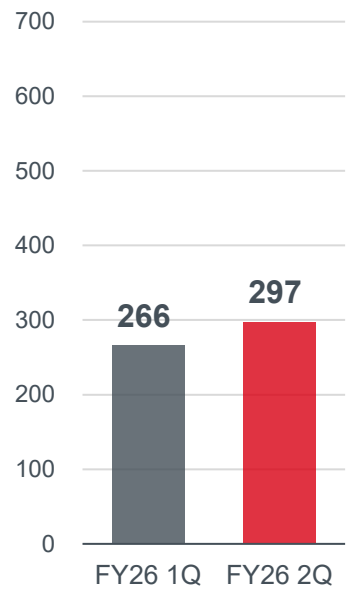
+10.1%



FA	+7
エネルギー	+5
ホームビルディング	+1
その他	+8

民生

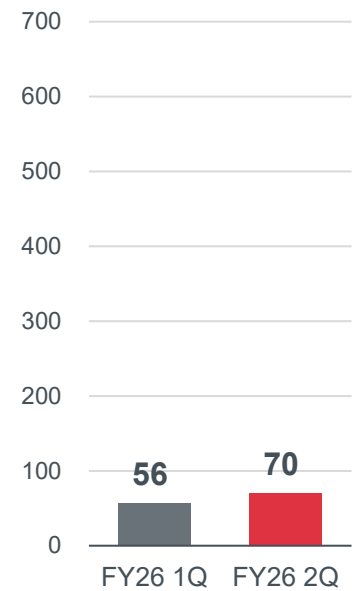
+11.8%



AV関連	+1
家電	▲7
その他	+37

通信

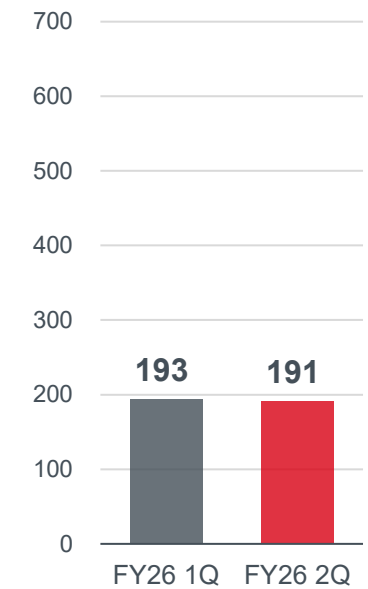
+24.2%



スマホ&モバイル	+11
基地局&インフラ	+3
有線通信	▲0

コンピュータ & ストレージ

▲1.4%



PC&サーバー	+8
決済端末	▲7
事務機	▲4

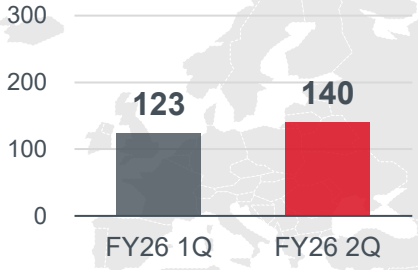
© ROHM Co., Ltd.

［FY2026 2Q実績］国籍別売上の変動要因（QoQ）

四半期売上高	FY2026 1Q実績	FY2026 2Q実績	
	1,357億円	1,437億円	+5.9%

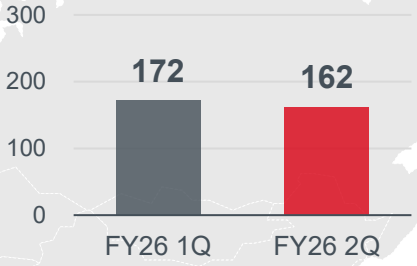
海外売上高比率	FY2026 1Q実績	FY2026 2Q実績
	47.5%	46.9%

欧州 +13.7%



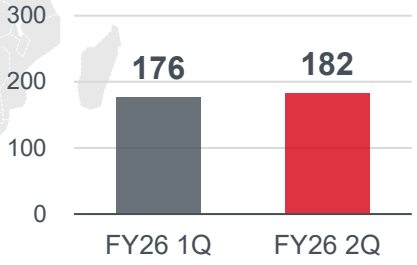
自動車	+14	通信	+0
産機	+2	C&S	▲0
民生	+1		

中国 ▲5.7%



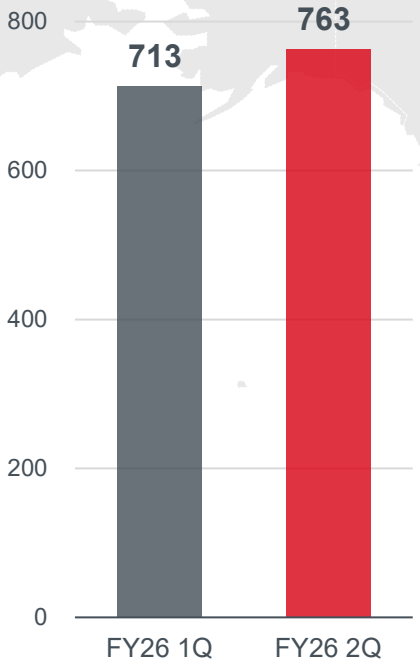
自動車	▲6	通信	+2
産機	+2	C&S	▲3
民生	▲4		

その他アジア +3.4%



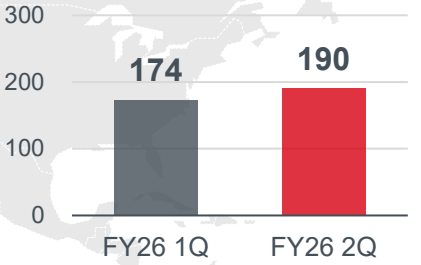
自動車	+0
産機	+3
民生	▲1
通信	▲1
C&S	+4

日本 +7.0%



自動車	+10	通信	+0
産機	+10	C&S	▲3
民生	+33		

米州 +9.8%



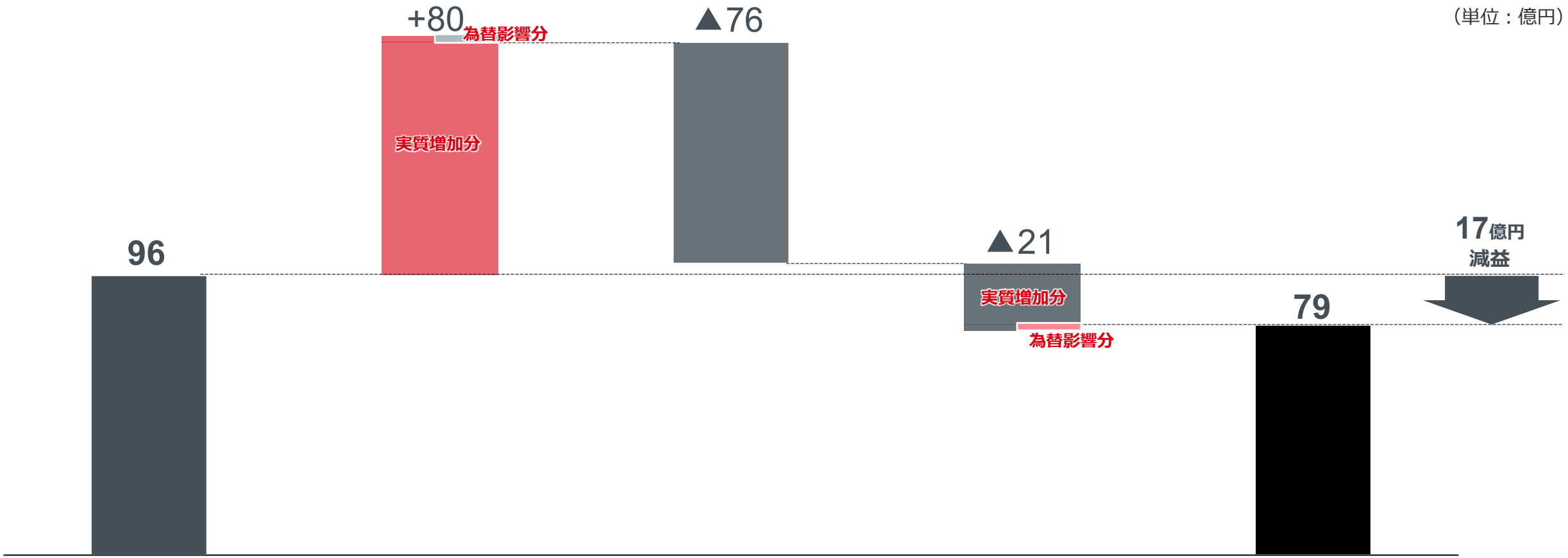
自動車	+0	通信	+12
産機	+2	C&S	▲0
民生	+3		

※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位：億円)

© ROHM Co., Ltd.

［FY2026 2Q実績］営業利益 増減分析（QoQ）

（単位：億円）



売上増加	+80
為替影響	▲2
実質増加	+82

市場別内訳

自動車	+18	通信	+14
産機	+20	C&S	▲3
民生	+31		

材料費及び在庫の影響	▲76
材料費	▲35
在庫の影響	▲41

固定費の増加	▲21
為替影響	+2
実質増加	▲23

製造原価

労務費	+11
償却費	▲13
経費	▲1

販管費

研究開発費	▲1
その他	▲17

［FY2026 2Q実績］セグメント利益（QoQ）

（単位：億円）

		FY2026 2Q 実績	FY2026 1Q 実績	増減額	増減率
LSI	売上	667	621	+46	+7.3%
	セグメント利益	102	73	+29	+40.0%
	（利益率）	(15.4%)	(11.8%)	-	-
半導体素子	売上	618	589	+29	+4.8%
	セグメント利益	▲34	▲9	▲25	-
	（利益率）	(▲5.6%)	(▲1.6%)	-	-
モジュール	売上	83	81	+2	+3.0%
	セグメント利益	7	10	▲3	▲32.5%
	（利益率）	(8.2%)	(12.6%)	-	-
その他	売上	70	66	+4	+5.4%
	セグメント利益	9	9	+0	+4.3%
	（利益率）	(13.5%)	(13.7%)	-	-